

/ LHS2

Herramienta no pelable con silicona para la semi conductora



Ver la ficha técnica
en línea



/ Uso

La herramienta LHS2 retira el semiconductor no pelable haciendo un tope recto.
Uso de la herramienta con silicona..

/ Ventajas

- Rugosidad mínima sobre el aislamiento
- Contrahierro para regular el avance de la herramienta y facilitar la rotación

/ Características

- **Herramientas específicas :** Herramientas para cables
 - **Herramientas para cables :** Herramientas de preparación de cables
 - **Para cables de red :** media tensión
 - **Embalaje :** Caja de cartón
 - **Peso (kg) :** 2
 - **Longitud (mm) :** 425
 - **Ancho (mm) :** 105
 - **Altura (mm) :** 85
- **Diámetro máximo (mm) :** 60
 - **Diámetro mínimo (mm) :** 38
 - **Profundidad de corte MAX (mm) :** 5

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
 LASC2		Blade for non-peelable semiconductor

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
 LH2		Herramienta para quitar el aislamiento